

## 本期封面



1999年6期

栏目:

DOI:

论文题目: 快速凝固Cu-Cr合金时效析出的共格强化效应

作者姓名: 刘平 康布熙 曹兴国 黄金亮 顾海澄

工作单位: 西安交通大学材料科学院, 西安710049

通信作者: 曹兴国

通信作者Email: [Liuping@lit.net.cn](mailto:Liuping@lit.net.cn)

文章摘要: 采用单辊快速凝固的方法制备Cu-Cr合金微晶薄带, 经适当的时效处理, 可以在导电率不降低的前提下, 显著提高合金的强度和硬度, 强度和硬度的提高主要是由晶粒细化和共格弥散析出强化所造成, 共格硬化效果与采用Gerold公式计算的结果非常接近, 与常规固溶处理的Cu-Cr合金相比, 峰值硬度提高了1.6倍, 其中27%由细晶强化产生.

关键词: 快速凝固 共格强化效应 铜铬合金

分类号: TG146.11

关闭